

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分  
 【発行日】平成 28 年 3 月 10 日 (2016.3.10)

【公表番号】特表 2015-508234 (P2015-508234A)  
 【公表日】平成 27 年 3 月 16 日 (2015.3.16)  
 【年通号数】公開・登録公報 2015-017  
 【出願番号】特願 2014-556596 (P2014-556596)  
 【国際特許分類】

H 0 1 L 23/14 (2006.01)  
 H 0 1 L 23/12 (2006.01)  
 H 0 1 L 21/60 (2006.01)  
 H 0 1 L 25/04 (2014.01)  
 H 0 1 L 25/18 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 23/14 S  
 H 0 1 L 23/12 5 0 1 B  
 H 0 1 L 21/60 3 1 1 S  
 H 0 1 L 25/04 Z

【手続補正書】  
 【提出日】平成 28 年 1 月 22 日 (2016.1.22)  
 【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲  
 【補正対象項目名】全文  
 【補正方法】変更  
 【補正の内容】  
 【特許請求の範囲】  
 【請求項 1】

インタポーザを作製する方法であって、  
 第 1 の表面を有するドナー体を供給するステップと、  
 前記ドナー体の前記第 1 の表面にイオンを注入して劈開面を規定するステップと、  
 第 1 の仮キャリアを前記ドナー体の前記第 1 の表面に分離可能に接触させるステップと

、  
 前記劈開面において前記ドナー体から薄片を劈開するステップとを備え、前記劈開面は前記薄片の裏面を形成し、前記ドナー体の前記第 1 の表面は前記薄片の前面であり、前記薄片は前記前面から前記裏面までの厚さを有し、さらに、

前記薄片にビアホールを形成するステップを備え、前記ビアホールは前記薄片の厚さにわたって貫通して延在し、さらに、

前記薄片から前記第 1 の仮キャリアを除去するステップを備える、方法。

【請求項 2】

インタポーザを作製する方法であって、

前面および裏面を有する薄片を供給するステップを備え、前記薄片は前記前面と前記裏面との間の厚さを有し、前記厚さは 15 ミクロン～40 ミクロンであり、さらに、

前記薄片の前記前面または前記裏面に仮キャリアを接触させるステップと、

前記薄片にビアホールを形成するステップとを備え、前記ビアホールは、最初に形成された状態では、前記薄片の前記厚さにわたって貫通して延在し、さらに、

前記薄片から前記仮キャリアを除去するステップを備える、方法。